

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰明镓”）。士兰集成、士兰明镓均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年6月1日至2024年6月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了担保金额为0.65亿元的最高额担保合同，为士兰明镓签署了担保金额为1.20亿元的担保合同。

截至2024年6月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为5.12亿元，公司为士兰明镓实际提供的担保余额为3.41亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 上述担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024年6月1日至2024年6月30日，公司在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
最高额保证合同	2024年6月3日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行	担保的本金最高余额为人民币0.65亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
保证合同	2024年6月26日	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币1.20亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70% 以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为 70% 以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至 2024 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在公司 2024 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024 年 6 月 30 日：

1、公司为士兰集成提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 5.12 亿元；公司为士兰明镓实际提供的担保余额为 3.41 亿元，其中日常担保余额为 1.20 亿元，专项担保余额为 2.21 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为 21.95 亿元，剩余可用担保额度为 7.05 亿元。担保余额在公司 2023 年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至 2024 年 6 月 30 日，被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
杭州士兰集成电路有限公司	913301017265863549	2001 年 1 月 12 日	浙江杭州	陈向东	90,000	99.17		芯片制造

厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	91350200MA31GA8D5D	2018年2月1日	福建厦门	陈向东	246,038.29	48.16		化合物芯片制造
------------------	--------------------	-----------	------	-----	------------	-------	--	---------

(二) 被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下:

(单位: 人民币 万元)

项 目	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	172,698	177,213
负债总额	80,518	84,401
净资产	92,180	92,812
营业收入	28,824	140,565
净利润	-633	-7,802

被担保人士兰明镓最近一年及一期的主要财务数据如下:

(单位: 人民币 万元)

项 目	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	332,991	314,787
负债总额	185,645	175,028
净资产	147,346	139,759
营业收入	14,335	53,912
净利润	-7,412	-33,169

(三) 士兰集成、士兰明镓均为本公司的控股子公司, 其未被列为失信被执行人, 不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行	担保的本金最高余额为人民币 0.65 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	若主合同为借款合同或贵金属租赁合同, 则本合同项下的保证期间为: 自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年; 甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的, 则保证期间为借款或贵金属租赁提

						前到期日之次日起三年
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	国家开发银行厦门市分行	担保的债权额为人民币 1.20 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期限届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰明镓日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集成、士兰明镓均为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 48.066 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.98%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 39.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日